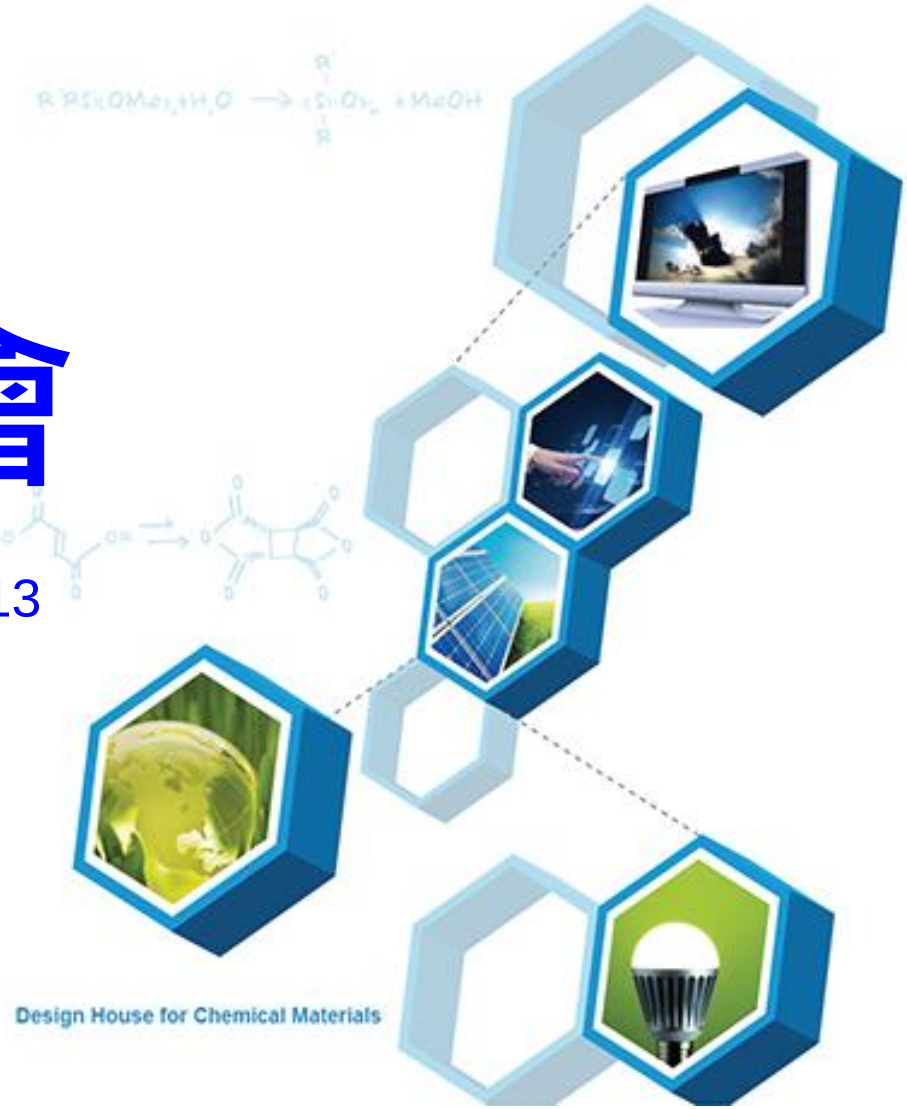
DAXIN

達興材料股份有限公司

股票代碼：5234

法人說明會

2023.12.13



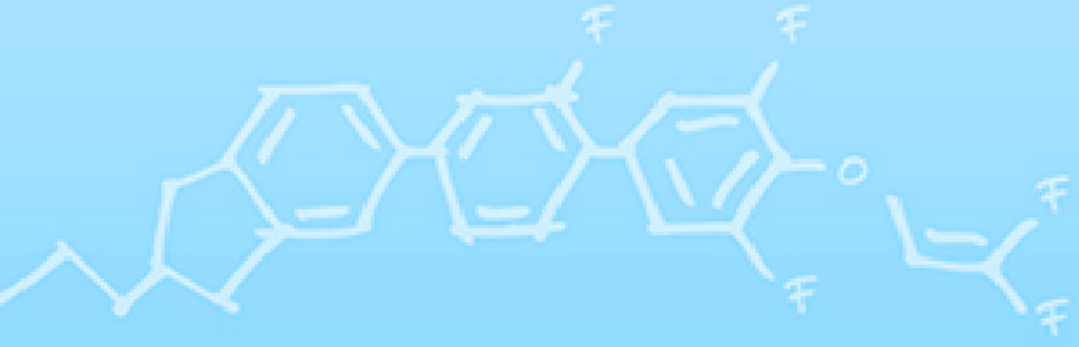
免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。

- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

簡報大綱

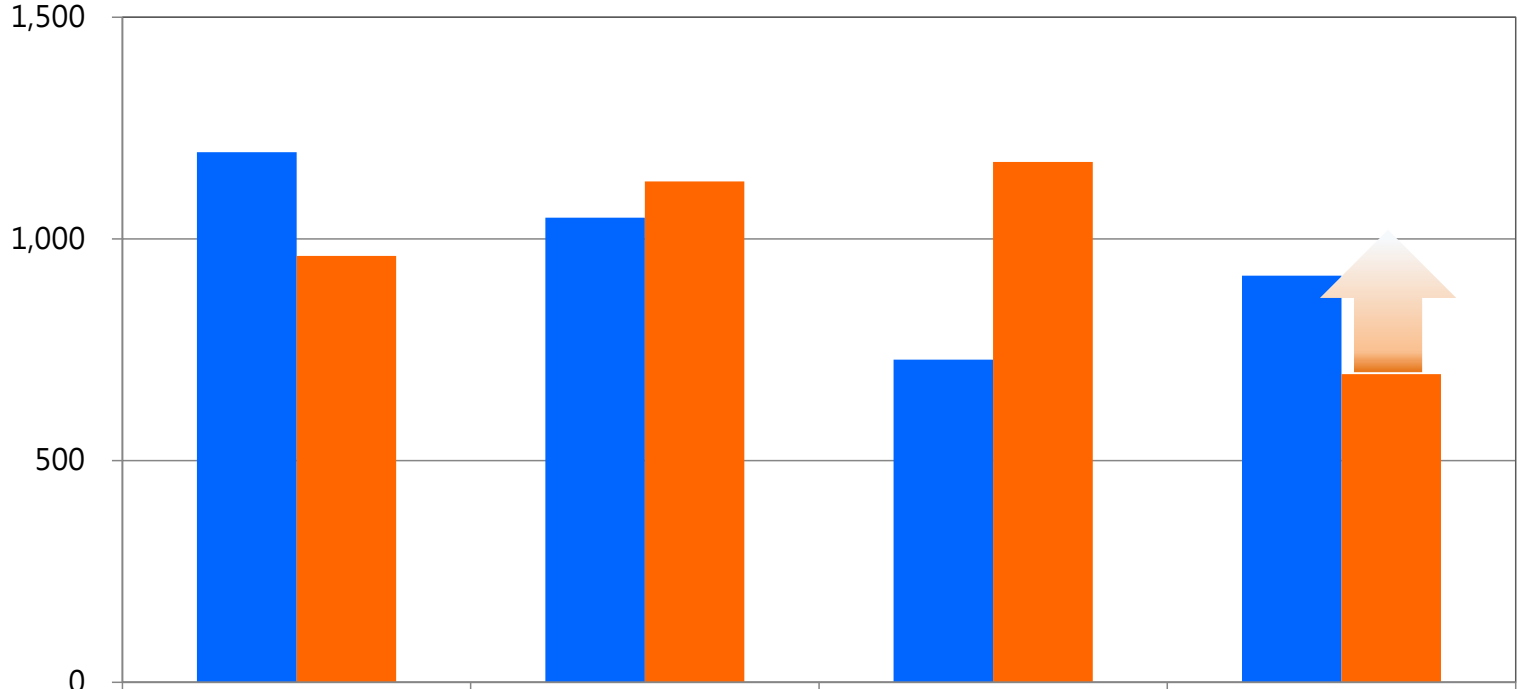
- 經營成果
- 營運概況與未來展望



經 營 成 果

營業額

Unit: NTD M



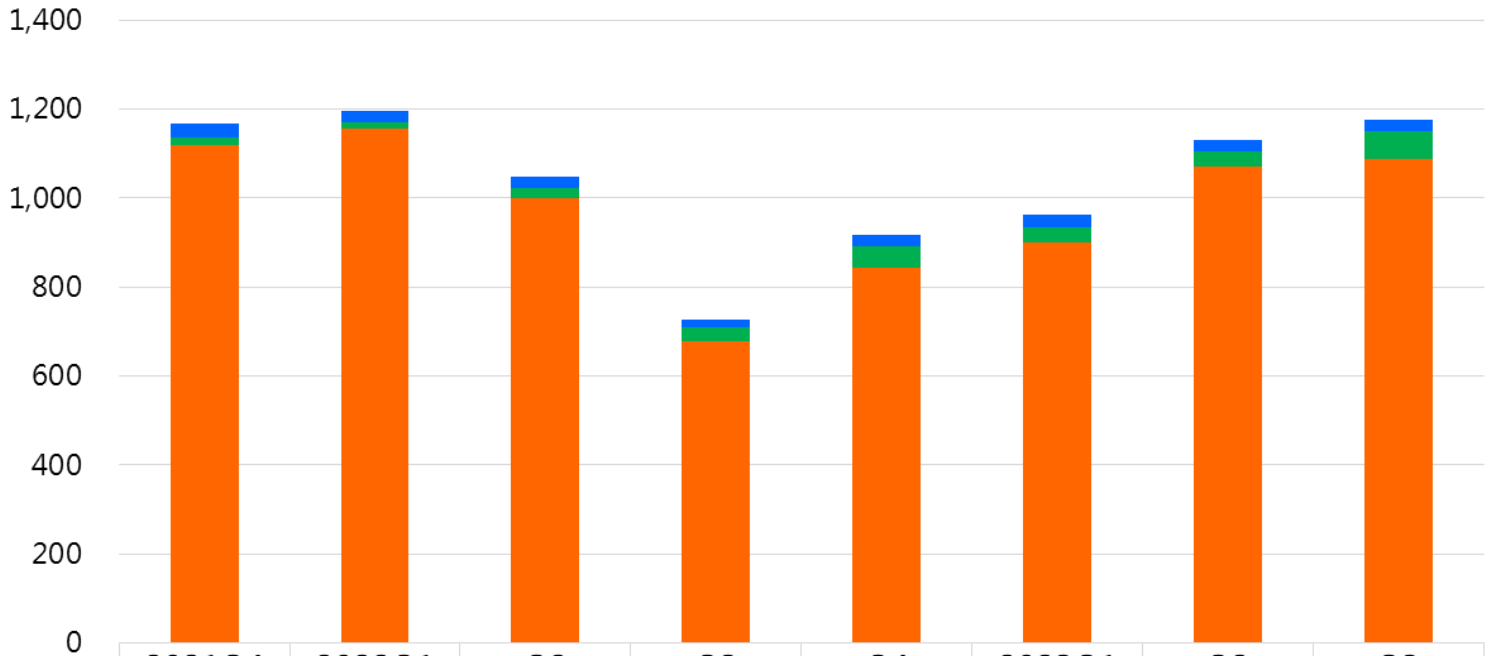
	Q1	Q2	Q3	Q4
2022 Sales	1,196	1,048	728	917
2023 Sales	962	1,130	1,174	695

◆ 2023年 1-11月營收 3,961M，較去年同期 3,576M，增加 10.8%。

註：2023Y Q4 為 10~11月自結數

產業別營收

(NTD M)



	2021Q4	2022Q1	Q2	Q3	Q4	2023Q1	Q2	Q3
關鍵原材料及其他	30.9	26.1	27.3	17.4	25.9	27.8	26.6	25.2
半導體材料	17.9	14.8	20.8	31.8	50.0	34.4	34.1	61.0
顯示器材料	1,118.9	1,155.4	1,000.0	678.4	841.5	899.7	1,069.6	1,088.1
TOTAL	1,167.7	1,196.3	1,048.1	727.6	917.3	961.9	1,130.3	1,174.3
關鍵原材料及其他佔比	2.6%	2.2%	2.6%	2.4%	2.8%	2.9%	2.4%	2.1%
半導體佔比	1.5%	1.2%	2.0%	4.4%	5.5%	3.6%	3.0%	5.2%

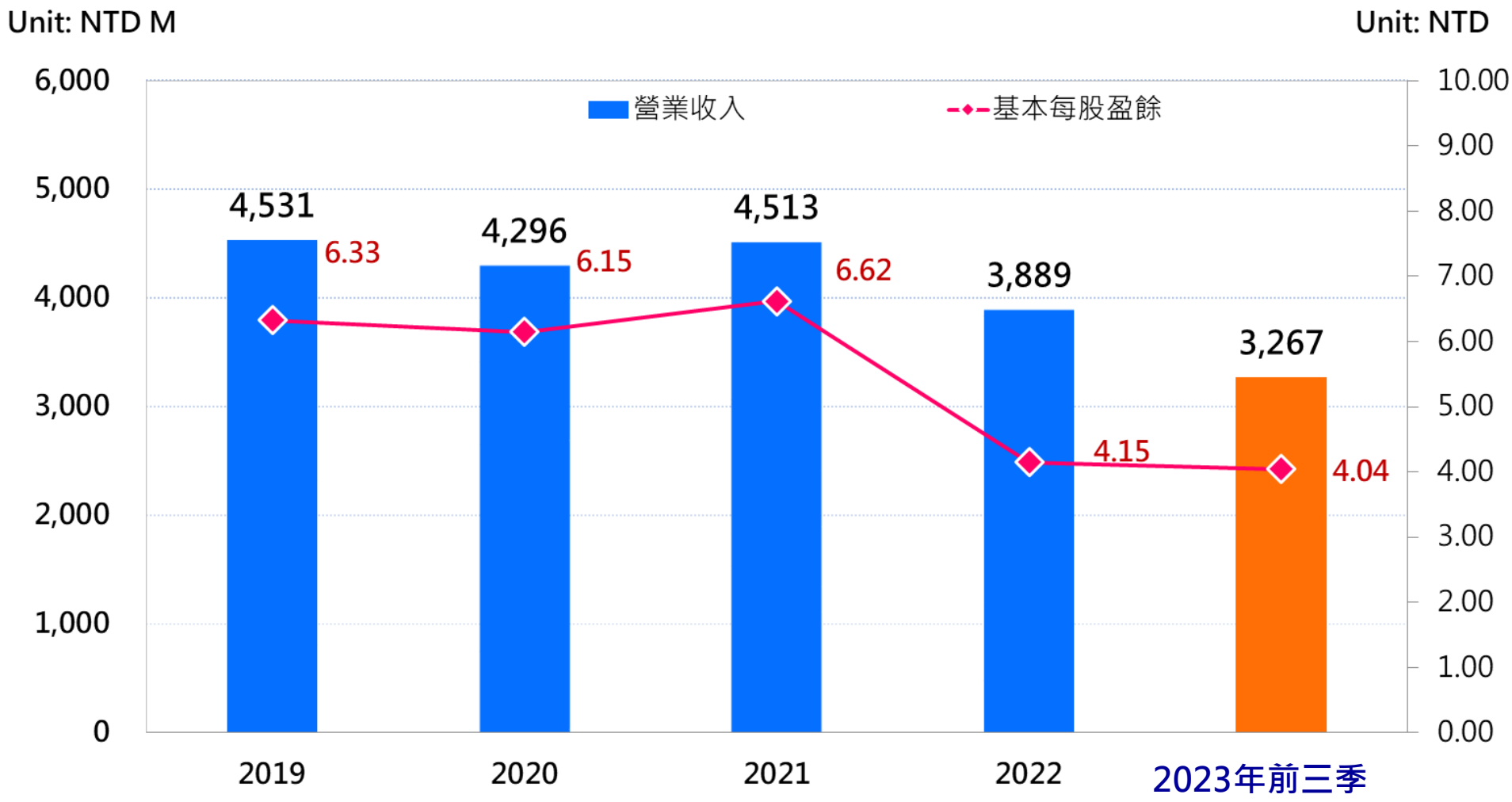
合併綜合損益表

DAXIN

Unit : NTD M	2023 Q1		2023 Q2		2023 Q3		2023 前三季		2022 前三季		年成長%
營業收入	**962**	**100.0%**	**1,130**	**100.0%**	**1,174**	**100.0%**	**3,267**	**100.0%**	**2,972**	**100.0%**	**9.9%**
營業成本	651	67.7%	739	65.4%	748	63.7%	2,138	65.5%	2,025	68.2%	5.6%
營業毛利	**311**	**32.3%**	**391**	**34.6%**	**427**	**36.3%**	**1,128**	**34.5%**	**947**	**31.8%**	**19.2%**
營業費用	196	20.3%	219	19.4%	240	20.4%	655	20.1%	613	20.6%	6.9%
營業淨利	**115**	**11.9%**	**172**	**15.2%**	**187**	**15.9%**	**473**	**14.5%**	**334**	**11.2%**	**41.8%**
營業外收(支)	(2)	(0.2%)	4	0.4%	7	0.6%	9	0.3%	50	1.7%	(81.4%)
稅前淨利	**113**	**11.8%**	**176**	**15.6%**	**194**	**16.5%**	**483**	**14.8%**	**384**	**12.9%**	**25.7%**
本期淨利	**98**	**10.2%**	**150**	**13.3%**	**166**	**14.1%**	**415**	**12.7%**	**339**	**11.4%**	**22.4%**
基本每股盈餘 (NTD)	**0.96**		**1.46**		**1.62**		**4.04**		**3.30**		

◆ 2023年 1-11月稅前淨利為 579M ，較去年同期447M，增加 29.5% 。

營收與獲利趨勢


Unit: NTD M
Unit: NTD
營業收入
基本每股盈餘
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
4,531
6.33
4,296
6.15
4,513
6.62
3,889
4.15
3,267
4.04
2019
2020
2021
2022
2023年前三季

合併資產負債表摘要

DAXIN

Unit: NTD M	2023/9/30		2022/9/30		年成長	年成長 %
現金及約當現金	265	5.7%	196	4.6%	69	34.9%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	889	19.0%	1,033	24.4%	(144)	(14.0%)
應收帳款	1,228	26.3%	813	19.2%	415	51.0%
存貨	385	8.2%	382	9.0%	4	0.9%
不動產、廠房及設備	1,572	33.6%	1,576	37.2%	(4)	(0.3%)
使用權資產	166	3.6%	175	4.1%	(9)	(5.4%)
資產總計	**4,673**	**100.0%**	**4,242**	**100.0%**	**431**	**10.2%**
流動負債	1,202	25.7%	895	21.1%	307	34.3%
非流動負債	446	9.5%	485	11.4%	(39)	(8.1%)
負債總計	**1,648**	**35.3%**	**1,380**	**32.5%**	**268**	**19.4%**
權益總計	**3,025**	**64.7%**	**2,862**	**67.5%**	**163**	**5.7%**

重要財務指標		
流動比率%	**242%**	**276%**
存貨週轉天數	**48**	**50**

合併現金流量表摘要

DAXIN

Unit: NTD M	2023 前三季	2022 前三季
本期稅前淨利	483	384
折舊及攤銷	193	164
營運資金變動	(202)	166
營業活動之淨現金流入	**402**	**623**
取得不動產、廠房及設備	(170)	(173)
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	165	(92)
投資活動之淨現金流出	**(9)**	**(267)**
舉借短期借款	195	120
償還短期借款	(195)	(120)
舉借長期借款	60	182
償還長期借款	(53)	(6)
發放現金股利	(339)	(544)
籌資活動之淨現金流出	**(339)**	**(375)**
本期現金及約當現金增加(減少)	**54**	**(19)**
期末現金及約當現金餘額	**265**	**196**

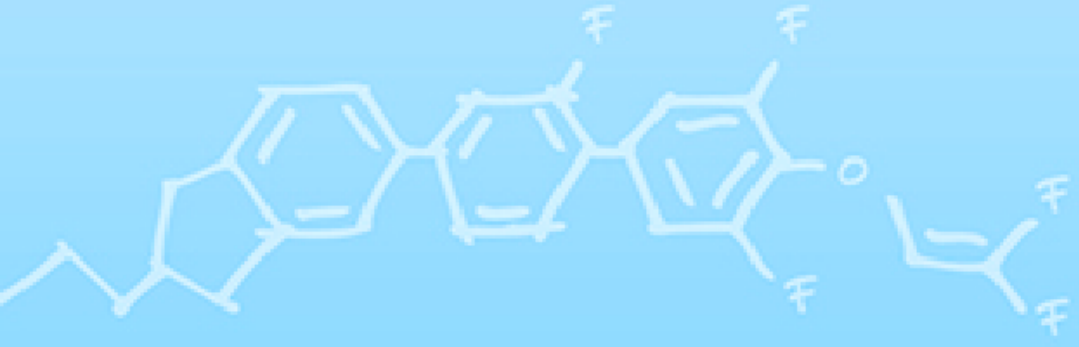
註：2023/9/30及2022/9/30期末現金及約當現金加計超過三個月以上定存餘額分別為1,153M及1,229M 。

股利政策

DAXIN

■ 維持高配息政策。

年度	EPS	現金股利	股票股利	股利發放比率
2022	4.15	3.3	0.0	80%
2021	6.62	5.3	0.0	80%
2020	6.15	5.0	0.0	81%
2019	6.33	5.0	0.0	79%
2018	6.38	5.0	0.0	78%



營運概況與未來展望

營運據點

DAXIN

營運總部/研發中心 – 台中中科

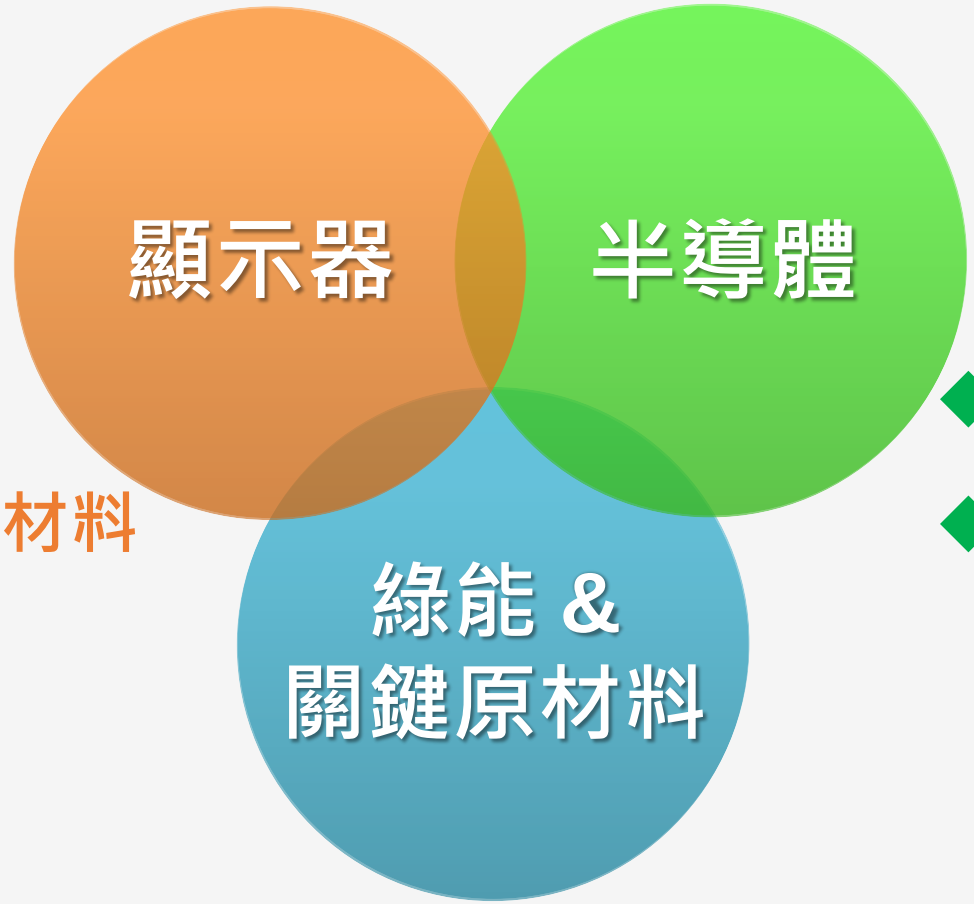
先進製造中心 II – LCD材料廠

先進製造中心 II – 半導體材料廠

先進製造中心 I – 台中中科

- **先進製造中心 I 及 先進製造中心 II – LCD材料廠:**
  分別已有 半導體產線 投入生產 半導體產品，量產出貨中。
- **先進製造中心 II – 半導體材料廠:**
  以半導體高純度合成、純化、配方生產線為主，2023/12 兩條產線投入小量產。

產品佈局



- LCD 材料
- MicroLED材料

- 先進製程材料
- 先進封裝材料

2023 經營成果

顯示器

DAXIN

■ **LCD Color Filter_ 感光間隙材PS :**

高精細PS 新產品導入客戶新產線，保持市占領先。

■ **LCD Cell_ 液晶配向膜PI :**

PSA PI (Polymer Stabilized Alignment) 平行展開導入各機種量產，

2024年導入新客戶新機種，將擴大營收貢獻。

■ **LCD Array_ 銅蝕刻液 :**

8K產品為市場主要供應商之一，新規格產品開發完成。

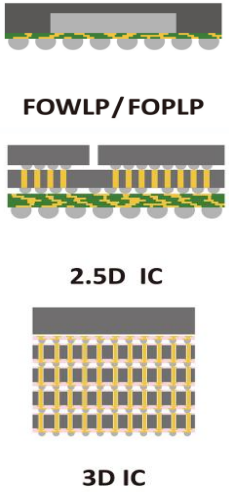
2023 經營成果

半 導 體

DAXIN

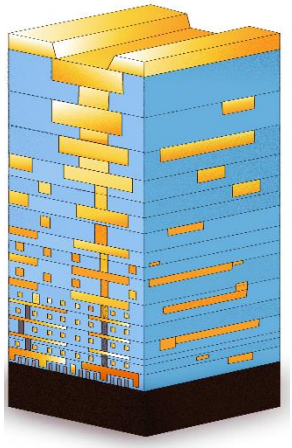
■ 先進封裝 (晶圓級/面板級)

- 有機離型層 : 穩定量產，平行展開導入新客戶。
- 光阻剝離液A : 穩定量產，終端產品持續放量。
- 高選擇比銅蝕刻液A : 驗證通過，開始投入小量產。



■ 晶圓製程 (先進製程/成熟製程)

- 高純度溶劑 : 穩定量產，平行展開導入新客戶。
- 光阻剝離液B : 穩定量產，延伸至下一節點製程應用。
- 高選擇比銅蝕刻液B : 驗證通過，開始投入小量產。
- 高純度高分子 : 驗證通過，2024年擴大營收貢獻。
- 底部抗反射層剝離液: 驗證通過，開始投入小量產。



研發計畫 - 顯示器

DAXIN

- 優化生產製程，掌握自製關鍵原材料，提高成本競爭力。
- 開發 更高規格材料 及 符合ESG低碳永續之低溫製程材料。

LCD Color Filter

- 低溫 感光間隙材 PS
- 低溫 熱固化平坦層TOC
- 低溫 黑色光阻 BM

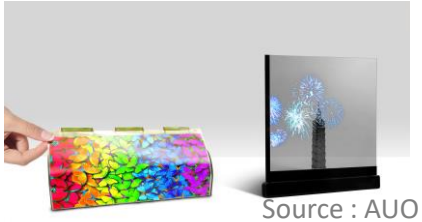
LCD Cell & Array

- 低溫 液晶配向膜PI
- FFS* 液晶配向膜PI
- 細線寬 銅蝕刻液

MicroLED

- 巨量轉移接著膠
- 白色光阻

Source : AUO



Source : AUO

*FFS : Fringe-field switching

研發計畫 - 半導體

DAXIN

- 精進半導體級超高純度化學品之合成及純化技術。
- 建立超微量不純物及奈米粒子分析檢測技術能力。

先進封裝

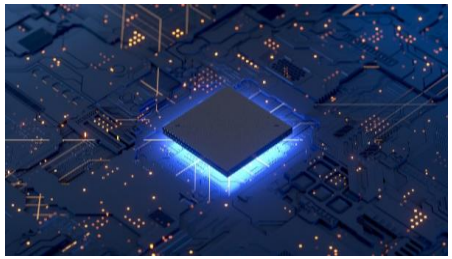
- 高解析 感光介電材
- 低溫低介電 感光介電材
- 耐高溫接著膠

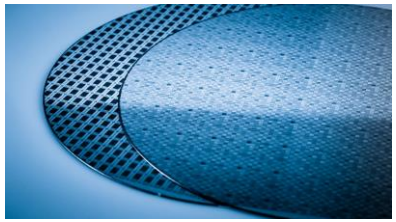
先進製程 BEOL

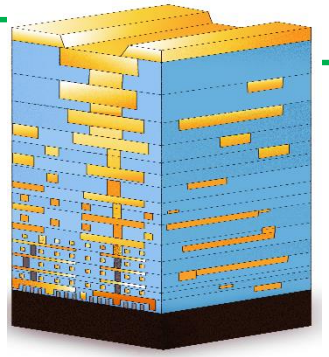
- 高純度特用清洗液A
- 高純度特用清洗液B
- 高純度表面處理液A

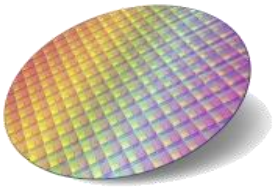
先進製程 FEOL

- 特用保護框膠
- 高純度表面處理液B









營運計畫 - 半導體

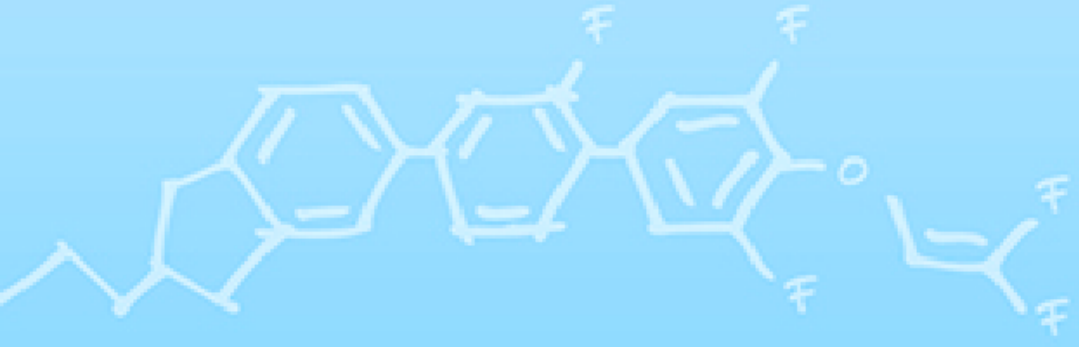
DAXIN

DAXIN 自主開發

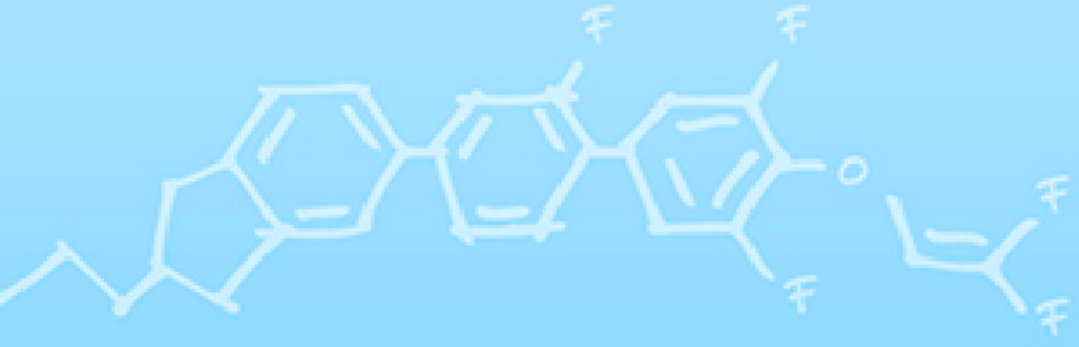
- 提升半導體材料驗證在客戶產線問題之應對速度。
- 布局下一世代先進製程及先進封裝所需新材料。

國際大廠合作

- 擴大與國際大廠策略合作項目及模式。
- 精進半導體級化學品合成純化製造能力。



Q & A



Thank you